



SPRS TECHNOLOGIES

P/N:STLP315-G188

Thin Film Planar Filters

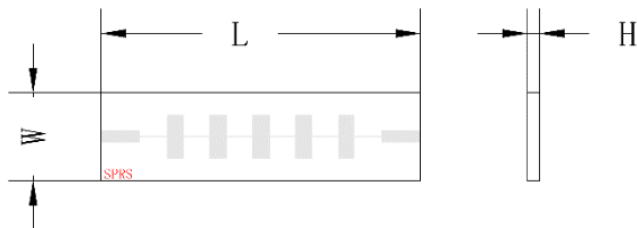
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

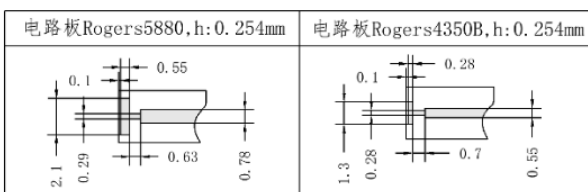
技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		15.75		GHz
工作频率	DC		31.5	GHz
中心损耗		0.6	0.9	dB
截止频率损耗		2.3	2.8	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@36.8-50.0GHz	45	50		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 5.5, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:

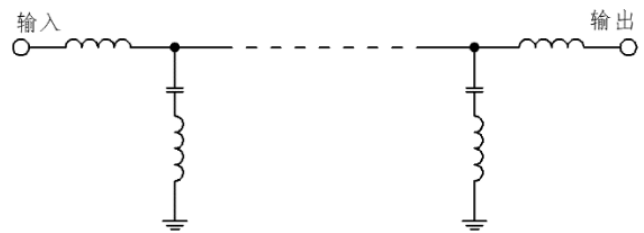


注意事项:

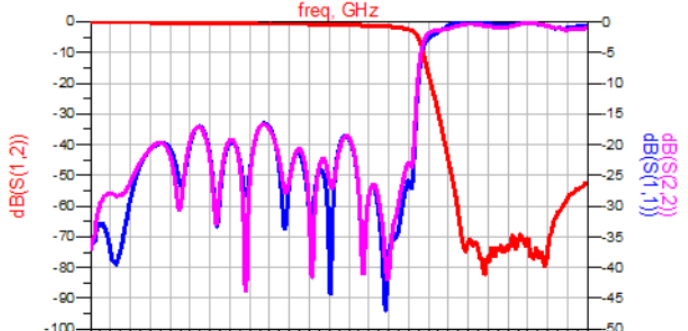
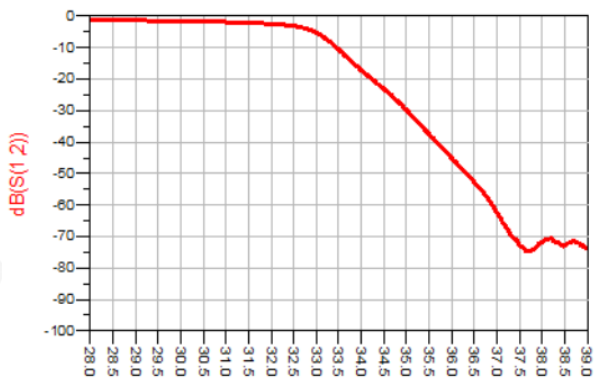
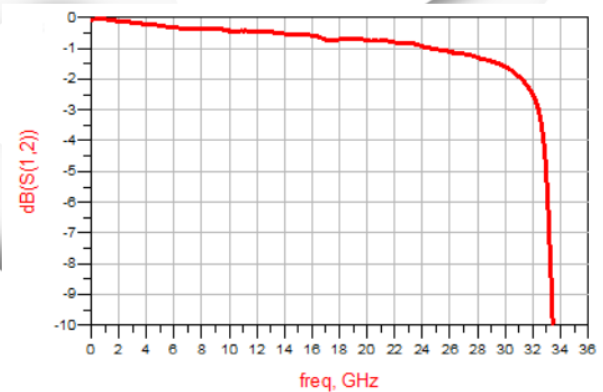
1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖1.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

原理图

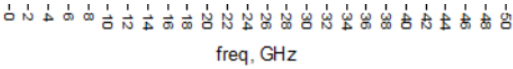


典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$



COM-MW TECHNOLOGY

4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配；



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。